第一图书网, tushu007.com

# <<电子封装工程>>

## 图书基本信息

书名：<<电子封装工程>>

13位ISBN编号：9787302063476

10位ISBN编号：7302063478

出版时间：2003-9

出版时间：清华大学出版社

作者：田民波

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

## 内容概要

本书是《新材料及高技术中的应用丛书》的第三册，内容包括电子封装工程概述、电子封装工程的演变与进展、薄膜材料与工艺、厚膜材料与工艺、有机基板、无机基板、微互联技术、封装与封接技术、BGA与CSP封装、电子封装的分析、评价及设计、超高密度封装的应用和发展等内容。
书中从微电子封装的基本概念及其演变与进展入手，针对高密度电子封装，详细讨论了制造工艺、相关材料及应用等各个方面，内容适用于微电子、电子元器件、半导体、材料、计算机与通信、化工、机械、塑料加工等各个领域的人员阅读。
本书可以作为相关专业本科生、研究生的教材，也可作为广大科技工作者、工程技术人员的参考书。

第一图书网, tushu007.com



版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com